

ASIGNATURA: 14143 - DISEÑO AVANZADO DE PCBS Y MCMS

CENTRO: Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica

TITULACIÓN: Ingeniero en Electrónica

DEPARTAMENTO: INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA

ÁREA: Tecnología Electrónica

PLAN: 10 - Año 2000**ESPECIALIDAD:**

CURSO: Cuarto curso **IMPARTIDA:** Segundo semestre **TIPO:** Optativa

CRÉDITOS: 4,5

TEÓRICOS: 3

PRÁCTICOS: 1,5

Descriptores B.O.E.

Herramientas software de diseño de PCBs avanzados y circuitos híbridos. Placement y Routing. Técnicas de apantallamiento. Integración electromecánica de equipos. Análisis térmico. Diseño mecánico. Técnicas, procesos y equipos de fabricación de prototipos y producción en serie. Encapsulados. EMC y EMI.

Temario

1. Procesos tecnológicos de fabricación (8h)
 - * Etapas del proceso de fabricación.
 - * Tarjetas de taladros no metalizados.
 - * Tarjetas multicapa.
2. Técnicas de Diseño de PCBs (4h)
 - * Captura de esquemáticos.
 - * Generación de netlist.
 - * Diseño del PCB.
 - * Diseño para ensamblaje.
 - * Inspección final de la tarjeta.
3. Elementos de integridad de la señal en PCBs (4h)
 - * Introducción.
 - * Elementos de integridad de la señal.
 - * Interferencia Electromagnética (EMI).
 - * Reflexión y Líneas de Transmisión.
 - * Crosstalk.
 - * Alimentaciones y desacoplo.
4. Introducción a los MCM (2h)
 - * Definición y clasificación.
 - * Tecnologías de fabricación.
5. Fundamentos del Diseño Electrónico (2h)
 - * Análisis de propagación de la señal.

- * Alimentación y masa.

6. Modelado y Simulación.

- * Caracterización y extracción de parámetros (2h)
- * Modelos de interconexión.

7. Diseño Térmico.

- * Fundamentos de transferencia de calor (2h)
- * Sistemas de refrigeración.

8. Análisis de Viabilidad (2h)

- * Métricas y partición.
- * Distribución de potencia y calor.
- * Análisis de costes.

9. Flujo de Diseño (2h)

- * Metodología.
- * Especificación, captura y simulación.
- * Análisis y verificación final.
- * Ficheros para foundry.

10. Test del MCM (2h)

- * Known Good Die (KGD).
- * Test del sistema.
- * Reparabilidad.

Conocimientos Previos a Valorar

Al tratarse una asignatura de Segundo Ciclo los alumnos han tenido que cursar las asignaturas del primer ciclo, con los siguientes contenidos: electrónica básica, circuitos analógicos, circuitos digitales, sistemas digitales (microprocesadores) y diseño de sistemas electrónicos basados en microprocesador.

Es conveniente disponer de experiencia en el manejo de herramientas de diseño electrónico para la realización de las prácticas de curso.

Objetivos

Esta asignatura tiene por objeto formar al alumno en las técnicas modernas de diseño y fabricación de circuitos impreso, híbridos y MCMs, así como otros aspectos relacionados con la simulación, análisis y verificación de integridad de las señales antes de proceder a la fabricación industrial de las tarjetas y sistemas diseñados. La formación teórica se complementará con la realización de diseños prácticos de circuitos.

Metodología de la Asignatura

Al tratarse de una asignatura que contiene una parte teórica y otra práctica, los medios a utilizar son de diversa naturaleza. La parte teórica se impartirá utilizando medios estándar (pizarra, transparencias y proyector). Por otro lado la parte práctica se desarrolla en el laboratorio y hace uso de herramientas CAD para diseño electrónico, así como otra información relacionada disponible en Internet.

Evaluación

Actividades que liberan materia:

- Examen escrito sobre los contenidos teóricos (EX).
- Realización de las 3 prácticas (PR).

Actividades que no liberan materia y puntúan sobre la nota final:

- Trabajo sobre tema complementario al temario (TR).

Otras consideraciones:

- Cada una de las actividades indicadas se puntúa de 0 a 10.
 - Para poder superar la asignatura es necesario superar por separado cada una de estas actividades (puntuación mínima = 5).
 - La nota final (NF) de la asignatura se calcula mediante la media ponderada de la calificación obtenida en estas actividades y de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$NF = 0'2 \cdot EX + 0'2 \cdot TR + 0'6 \cdot PR$$

siempre con la condición de que EX, TR y PR sean ≥ 5 .

- El peso relativo de cada una de las 3 prácticas será de 10%, 30% y 60%, respectivamente.
- Al finalizar cada práctica se entregará una memoria que contenga los datos solicitados en el enunciado.
- El trabajo a presentar se realizará sobre un tema que el alumno elegirá de entre los temas propuestos por el profesor.

Descripción de las Prácticas

Las prácticas serán realizadas en el Laboratorio de VLSI y Test de la Planta 2ª del Pabellón A (Edificio de Electrónica y Telecomunicación).

Programa de Prácticas:

1. Introducción al uso de las herramientas (2h).
2. Desarrollo de librerías de componentes (4h).
3. Diseño de un PCB y/o MCM propuesto (9h).

Bibliografía

[1] Printed circuit board designer's reference: basic /

Christopher T. Robertson.

Prentice Hall,, Upper Saddle River, N.J. : (2004)

0130674818

[2] Signal integrity issues and printed circuit board design /

Douglas Brooks.

Prentice Hall,, Upper Saddle River, N.J. : (2003)

013141884X

[3] Advanced electronic packaging :with emphasis on multichip modules /

edited by William D. Brown ; IEEE Components, Packaging, and Manufacturing Technology Society, Sponsor.

Institute of Electrical and Electronics Engineers,, New York : (1999)

0-7803-4700-5

[4] Transparencias de clase

Jorge E. Monagas Martín

[5] Multichip module technology handbook /

Philip E. Garrou, Iwona Turlik.

Mac Graw-Hill,, New York : (1998)

0-07-022894-9

[6] Algorithms for VLSI physical design automation.

Sherwani, Naveed A.

Kluwer Academic,, Boston : (1993)

0792392949

[7] Physical design for multichip modules.

Sriram, Mysore

Kluwer Academic,, Dordrecht, NL :

079239450X

Equipo Docente

JORGE MONAGAS MARTÍN

(COORDINADOR)

Categoría: PROFESOR COLABORADOR

Departamento: INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA

Teléfono: 928457321 **Correo Electrónico:** jorge.monagas@ulpgc.es

WEB Personal: <http://www.diea.ulpgc.es/users/jmonagas/index.html>